

# 2017年度 京セラ株式会社 募集要項

## 1. 採用予定

【応募資格】 2017年3月 四年制大学卒業及び大学院修了見込みの方  
(浪人・留年については原則として計2年以内を目安とさせていただきます)

【採用予定】 理工系 130名 程度

【採用学科】 電気電子/機械/金属/制御/情報通信/化学/応用化学/材料/物理/知的財産 他

【求める人材像】  
・夢に向かって果敢にチャレンジし続けられる人  
・素直な心、ひたむきさを持っている人  
・グローバルな視点を持っている人  
(今後の事業のグローバル展開を踏まえ、目安としてTOEIC600点相当の語学力がある方は、更に歓迎します)

《専攻分野と採用比率目安》

電気電子/情報・通信系	機械系	化学材料系	物理	その他
30%	30%	30%	5%	5%

## 2. 応募方法

### (1) 修士・学部の方の応募方法について

下記2つのコースよりご選択いただき、ご応募ください。

※応募方法・詳細は別紙「応募概要」をご参照ください。

#### ① プロダクト別採用コース(対象: 推薦応募者限定)

弊社へ推薦応募を検討されている方は、ご本人の「希望・専門性」(学部生の場合は「学業の理解度とポテンシャル」と弊社プロダクト)とのマッチングを事前面談にて確認させていただきます。面談を通して、マッチングが確認できたプロダクトへの配属を前提に、その後の選考を進めます。

対象事業 : ①ファインセラミック部品 ②自動車部品 ③半導体部品 ④電子部品  
⑤プリンティングデバイス ⑥切削工具 ⑦宝飾・応用商品 ⑧エネルギー関連製品  
⑨通信機器 ⑩クリスタルデバイス ⑪生産技術開発・精機 ⑫ソフトウェア開発  
⑬有機材料部品  
※①～⑬は、各プロダクト部門の中に、研究開発が含まれています。

#### ② 職種別採用コース

下記の職種においては、職種別に適性を確認し、配属を決定させていただきます。

対象職種 : 特許・知的財産/社内SE(情報ネットワーク・システムエンジニア)/環境管理/電気設備管理

※①プロダクト別採用コースについて、6月1日以降にご応募いただいた場合には、配属先のプロダクトを限定しない採用方法に変更させていただく可能性があります。あらかじめご了承ください。

### (2) 博士の方の応募方法について

ご応募を検討される際は、ご本人からご連絡ください。応募時に、まず論文審査をさせていただきます。

本募集要項が到着以降随時、受付を行います。履歴書並びに専門分野に関する論文を下記弊社担当宛にご郵送ください。

論文審査合格の方に、選考のご案内をさせていただきます。

### (3) 理工系の知識を活用する「営業職」への推薦応募方法について

京セラでは、理工系の知識を活用して「営業職」として活躍いただける方についても、別途推薦でのご応募を受け付けております。

応募・選考方法が通常と異なりますので、ご希望の場合には下記弊社担当宛にご連絡ください。

### (4) 留学生の方の応募方法について

応募・選考方法が、上記と異なります。

学校推薦で応募を希望される場合には、事前に下記弊社担当宛にご連絡ください。

### (5) 自由応募の方の応募方法について

応募コース、選考方法が上記と異なります。

弊社HPのマイページをご確認の上、ご応募ください。

#### <技術系採用書類送付・お問い合わせ先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地  
京セラ株式会社 人材開発課(技術系担当) 田中・今野  
E-mail: misato.tanaka.nf@kyocera.jp, konno.shingo.yb@kyocera.jp  
TEL: 075-604-3510 (直通)  
※各コースへの応募書類ご郵送の際は、封筒に  
「〇〇採用コース応募書類在中」とご記載願います

京セラへの応募をお考えの方は

#### 『京セラ プロダクト別合同セミナー』

へぜひ、ご参加ください！ 各プロダクトが、事業や最先端技術を紹介します！

※プロダクト別合同セミナーは、3月下旬より、東京・博多・京都にて開催を予定しています。詳細は弊社HPエントリー後マイページよりご確認ください。



# 「プロダクト別採用コース」 応募概要

※プロダクト別採用コースについては、推薦応募をお考えの方に限定させていただきます。

## STEP.1 マッチング面談会

◆マッチング面談会の内容：  
ご希望のプロダクト（第2希望まで）の部門責任者と面談  
※面談結果は、面談終了後、2週間以内に就職ご担当教授もしくはキャリアセンターへフィードバックさせていただきます。

### (1) 面談会申込方法

1.大学 ⇒弊社へご連絡	就職ご担当教授もしくはキャリアセンターより面談会参加希望者を弊社担当までご連絡ください。  <面談会申込連絡内容> ①学生氏名 ②研究科名 ③専攻名 ④就職ご担当教授もしくはキャリアセンターのご連絡先をメール又はお電話で弊社担当へご連絡ください。
2.本人 ⇒弊社HPからエントリー	弊社新卒採用HPへエントリーください。 ※自己紹介シートには、HPエントリー受付時のIDナンバーの記入が必要となります。  <京セラ採用HPURL: <a href="http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/">http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/</a> >
3.本人 ⇒応募書類を弊社へ郵送	①「自己紹介シート(弊社指定)」 ②求人票に同封の書類送付案内 ③「成績証明書」※修士の方は学部分も必要 上記3点を締切までに、弊社担当まで郵送ください。  ※「自己紹介シート」書類送付案内をお持ちでない場合には、弊社HPへエントリー後マイページよりダウンロードが可能です。

### (2) 面談会申込締切

第1回受付 4月15日（金）書類到着分まで  
第2回受付 5月12日（木）書類到着分まで  
第3回受付 5月31日（火）書類到着分まで

### (3) 面談会日程

第1回受付の方 4月下旬  
第2回受付の方 5月中旬  
第3回受付の方 6月初旬

※お申し込みいただいた順に、詳細日程をご案内いたします。

### (4) 面談場所

京都、横浜、東京を予定  
(ご希望のプロダクトにより面談場所を決定いたします)

### (5) 交通費について

遠方者につきましては、弊社規定により交通費を一部補助いたします。  
(詳細は面談日時ご案内にてご連絡いたします)

### (6) マッチング面談会参加準備

1.弊社 ⇒本人へ日程のご連絡	応募書類到着後、弊社より面談の日時・場所・WEB検査やSPI受験について、メールにてご連絡いたします。
2.本人 ⇒Web適性検査・SPI試験の受	①面談日の3日前までに、弊社新卒採用HPのマイページより「WEBテスト・適性検査」を受検ください。 ②SPIテストセンターにて「SPIテスト」を受検ください。
3.本人 ⇒面談資料作成	◆下記資料2点を作成ください。  ①技術PR資料 (A4/1~3枚、形式自由) ⇒ご自身の研究内容についてのPR資料 ②自己PR資料 (A4/1枚、形式自由) ⇒研究内容以外で自分を紹介するPR資料  面談当日、各10部ご持参ください。 ※当日は、郵送いただいた「応募書類」と上記資料をもとに面談を実施させていただきます。

### (7) マッチング面談会結果フィードバックについて

面談後2週間以内に、マッチング結果を就職ご担当教授もしくはキャリアセンターへ電話もしくはメールにてフィードバックさせていただきます。

#### <マッチング面談不成立の場合について>

第2希望までのプロダクトとマッチングが成立しなかった方については、自由応募にて6月以降の選考に別途応募が可能です。

### (8) 推薦取得

推薦を取得していただき、最終選考にお越しください。

## STEP.2 最終選考

### ◆最終選考内容：面接

※原則として、面談でマッチング成立となったプロダクトへの配属を前提として、選考を行います。

### (1) 最終選考応募方法

1.本人 ⇒応募書類を郵送	下記の「最終選考必要書類」を弊社担当まで郵送ください。  <最終選考応募書類> ①推薦書 ②修了見込証明書 ※後日送付可 ③健康診断書 ※後日送付可  ※推薦書は、学部長・就職担当教授・指導教授のいずれの方からでも結構です。
------------------	---

### (2) 最終選考参加準備

1.弊社 ⇒本人へ日程のご連絡	応募書類到着後、弊社より最終選考の日時・場所をご本人へメールにてご連絡いたします。
<p>&lt;応募に際しての注意事項&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆マッチング面談成立後、最終選考への応募が遅れた場合には本コースで受付できない場合がございます。あらかじめご了承ください。(本コースのプロダクトごとの採用充足状況により、予告なく募集を締切らせていただく場合がございます。)</li> <li>◆大学側のご都合により、マッチング成立後、推薦応募までの日数がかかる場合には、事前に弊社担当へご相談下さい。</li> <li>◆プロダクトごとの採用枠が充足した場合は、弊社HPにて告知致します。</li> </ul>	

### (3) 最終選考日程

6月以降随時  
※応募書類が到着した順にご本人へ詳細をご案内いたします。

### (4) 最終選考場所

京都、東京、博多を予定

### (5) 交通費について

最終選考については、弊社規定により自宅から面接会場までの旅費を往復分支給いたします。

#### <技術系採用書類送付・お問い合わせ先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地  
京セラ株式会社 人材開発課(技術系担当) 田中・今野  
E-mail: misato.tanaka.nf@kyocera.jp, shingo.konno.yb@kyocera.jp  
TEL: 075-604-3510 (直通)  
※各コースへの応募書類ご郵送の際は、封筒に「〇〇採用コース応募書類在中」とご記載願います。

### 「職種別採用コース(推薦応募)の方へ

応募については、上記プロダクト別採用と同じ流れ(マッチング面談有)となります。

ただし、締切日及びマッチング面談時期については、各職種によって異なりますので、エントリー後マイページにてご確認をお願いいたします。

※最終選考は、プロダクト別採用コースマッチング成立の方と同様に、6月以降を予定しています。

### 「6月以降に推薦で応募をされる場合の留意事項」

- ①配属先のプロダクト、職種を限定しない応募方法に変更になる可能性があります。応募の際に担当までお問い合わせください。
- ②推薦応募が決定されましたら、就職担当教授もしくはキャリアセンターより弊社技術系採用担当までご連絡ください。
- ③応募書類については、以下の書類を弊社までご郵送ください。
  - ・自己紹介シート(表・裏)
  - ・推薦書
  - ・成績証明書(修士の方は、学部分も必要)
  - ・修了見込み証明書(後日送付可)
  - ・健康診断書(後日送付可)



## 自己紹介シートの記入要領(留意事項)

### 【表面】

- 「ID番号」(写真貼付欄下)は、弊社採用HPからエントリーした際に発行されるID(6桁の数字)です。  
応募前に必ず採用HPにてエントリーしていただき、自己紹介シートの記入欄にはID番号をご記入ください。  
※京セラ新卒採用HP エントリー先 URL : <http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/>

### 【裏面】

- 「卒業・修了研究概要」について、研究テーマが未定の方は、現在の専攻に基づき、最も関心を持っている研究分野について、またその理由についてご記入ください。
- 「専攻を活かしたい技術分野、携わりたい技術分野」については、自分の研究や専攻を活かしたい技術分野や、携わりたい技術分野を【技術分野】\*表1より選択してご記入ください。(3つ以内)
- 「希望するプロダクト及び職種」については、【プロダクト及び職種】\*表2 よりご選択ください。  
(1)プロダクト別採用コースの方 : プロダクト名称①～⑬から、必ず2つご選択ください。  
(2)職種別採用コースの方 : 職種名称①～④から、1つのみご選択ください。

#### ◆技術分野 \*表1

・材料技術 ・音響技術 ・結晶技術 ・薄膜/厚膜技術 ・誘電/圧電技術 ・材料分析評価技術 ・半導体技術	・実装技術 ・計測/制御技術 ・構造設計技術 ・機械/機構設計技術 ・精密加工技術 ・システム開発技術 ・特許/知的財産	・高周波通信技術 ・光通信技術 ・光学/光計測技術 ・画像処理/圧縮技術 ・シミュレーション ・CAD/CAM技術 ・安全防災	・ソフトウェア技術 ・電子回路技術(アナログ・デジタル) ・自動化/FA技術 ・IE/生産管理 ・品質評価/解析技術 ・環境管理/電気設備管理
--	--	---	--

※上記の◆技術分野について、該当する技術分野が無い場合には、自由にご記入ください。

#### ◆プロダクト及び職種 \*表2

- 各プロダクト及び職種の内容については、下記3点もご参考ください。
- ・募集要項に同封の「京セラ会社概要パンフレット」
  - ・「京セラ 新卒採用HP 事業紹介ページ」 ※HPの事業紹介ページについては、3月以降随時ご確認いただけます。

プロダクト名称	専攻分野	専攻分野				
		電気・電子系	機械系	化学/金属・材料系	物理系	情報・通信系
	各プロダクトの分野、製品等					
プロダクト名称	①ファインセラミック部品 ※半導体・液晶製造装置、サファイア単結晶製品、生活文化・産業機械用部品、環境・エネルギー関連用部品、医療機器用部品等	○	◎	◎	○	△
	②自動車部品 ※エンジン部品、カーエレクトロニクス部品、車載カメラモジュール等	◎	◎	◎	○	◎
	③半導体部品(セラミックパッケージ及び半導体関連材料、他) ※セラミックパッケージ用途/電子デバイス用、イメージセンサ用、IC/LSIデバイス用、LED用、通信モジュール用 ※半導体関連材料用途/半導体封止材料、半導体・電子部品組立材料、化成品、熱硬化性成型材料、機能性シート、他	◎	◎	◎	○	△
	④電子部品 ※コンデンサ、高周波モジュール(発振子、SAWフィルタ等)	◎	○	◎	○	△
	⑤プリンティングデバイス ※サーマルプリントヘッド、インクジェットプリントヘッド、アモルファスシリコンドラム	◎	◎	○	○	△
	⑥切削工具 ※切削チップ、切削ホルダ、ミーリング、ドリル、ソリッドエンドミル、スモールツール等	○	◎	◎	○	△
	⑦宝飾・応用商品 ※キッチン用品・ジュエリー・ステーショナリー・日用品		◎	◎	○	△
	⑧エネルギー関連製品 ※太陽電池、燃料電池、HEMS、システム開発	◎	○	◎	◎	△
	⑨通信機器 ※スマートフォン、携帯電話、PHS	◎	◎		○	◎
	⑩クリスタルデバイス ※タイミングデバイス(水晶発振機、水晶振動子、水晶デバイス等)、水晶応用製品(光デバイス)	◎	○	○	○	△
	⑪生産技術開発・精機 ※メカトロ技術開発・プロセス開発・設備開発、設計、製造	◎	◎	○		△
	⑫ソフトウェア開発 ※組み込みソフト、IoT・センサーネットワーク等の情報基盤技術、ビッグデータ・ヘルスケア等のサービスアプリケーション、画像処理、画像認識開発、人工知能等の先端ソフトウェア技術等	○				◎
	⑬有機材料部品(有機パッケージ・プリント配線版) ※パッケージ用途/サーバー、ルーター、携帯通信端末等 ※基板・配線版用途/スマートフォン、車載向けの通信モジュール、パソコン、携帯端末、ハイエンドサーバー、通信システム 等	◎	◎	○	○	△
職種名称		◎	○	○	○	◎
①特許・知的財産		◎	○	○	○	◎
②社内SE(情報システム・ネットワークエンジニア)					◎	
③環境管理(環境負荷低減施策の企画・立案)		○	○	◎	○	○
④電気設備管理(省エネ推進、電気設備設計、保守等)		◎	◎			

※①～⑬については、どの事業にも、研究、開発・設計、製造技術、生産技術、品質評価技術の職種があります。

※⑩クリスタルデバイスについては、京セラ(株)にて採用、京セラクリスタルデバイス(株)への出向配属となります。

# 自己紹介シート

年 月 日

写真貼付  
(縦4cm×横3cm)

ID番号

--	--	--	--	--	--

ふりがな					
氏名					
生年月日	19	年	月	日生	満( )歳
ふりがな					
現住所	〒( - )	TEL	-	-	-
		携帯	-	-	-
		E-mail			
ふりがな					
休暇中の連絡先	〒( - )	TEL	-	-	-

(西暦)年 月	学 歴		
			高等学校卒業
	大学	学部	学科 入学
	大学	学部	学科 卒業(見込)
	大学大学院	学研究科	専攻 修了(見込)
(西暦)年 月	留学経験 / 学会発表 / 賞罰 など		

英語	TOEIC / TOEFL	点	年 月 日 時点
その他言語 及び 保有資格			

得意な専門科目		
クラブ活動 (団体名・役職名)	高校	趣味・特技
	大学	
大学を通じて 得たもの		

長所		短所	
自己PR			

健康状態 (既往症)	
------------	--

# 卒業・修了研究概要

氏名	大学 大学大学院		学部 学研究科	学科 専攻
指導教官 氏名	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <span>教授</span> <span>准教授</span> <span>助教</span> <span>講師</span> </div>	テーマ		
<b>◆研究の概要とねらい</b> (研究内容の趣旨を分かりやすく記入し、ねらいについては研究の目的、関連研究における位置付けなどを記入する) ※研究テーマが未定の方は、現在の専攻に基づき、最も関心を持っている研究分野について、またその理由についてをご記入ください。				
<b>◆進捗状況</b> (研究の進み具合などを記入する) ※研究テーマが未定の方は、未記入で結構です。				

※別紙「記入要領」の※表1、表2より選択いただき、ご記入下さい。

1	応募方法	※右欄の <input type="checkbox"/> にチェック	<input type="checkbox"/> 推薦応募 <input type="checkbox"/> 自由応募	
2	応募コース	※右欄の <input type="checkbox"/> にチェック	<input type="checkbox"/> プロダクト別採用コース <input type="checkbox"/> 職種別採用コース <input type="checkbox"/> 全社チャレンジ採用コース	
3	専攻を活かしたい / 携わりたい技術分野	※別紙「記入要領」の表1、表2より選択、記入ください		
4	希望する「プロダクト」	希望1の理由		
	※ご応募の方(職種別採用コースのみ除く)は、下記の <input type="checkbox"/> にプロダクトの希望順位(1、2)を記入下さい。⑧については、併せて希望の製品に○をしてください。	-----		
	①ファインセラミック部品	⑦宝飾・応用商品	-----	
	②自動車部品	⑧エネルギー関連製品 (SE/SOFC/HEMS)	-----	
	③半導体部品	⑨通信機器	-----	
	④電子部品	⑩クリスタルデバイス	-----	
	⑤プリンティングデバイス	⑪生産技術開発・精機	希望2の理由(※職種別採用コースの方は不要です)	
	⑥切削工具	⑫ソフトウェア開発	-----	
5	希望する「職種」(職種別採用コース)			-----
	<input type="checkbox"/> 特許・知的財産 <input type="checkbox"/> 社内SE <input type="checkbox"/> 環境管理 <input type="checkbox"/> 電気設備管理 ※希望の職種の <input type="checkbox"/> にチェックを入れてください			-----



2016年 月 日

京セラ株式会社  
人材開発部長 大西 実 宛

大学(大学院)

学部(研究科)

学科(専攻)

## 書類送付案内

下記コースの求人に対し、入社を希望している学生の関係書類を送付します。

1. 応募学生 氏名 : \_\_\_\_\_ (大学院生 / 学部生)

指導教官 : \_\_\_\_\_ 職位 : \_\_\_\_\_

2. 応募コース  プロダクト別採用コース  
 職種別採用コース

3. 同封書類  自己紹介シート  推薦書 [後日送付可]  
 成績証明書(修士)  修了見込み証明書 [後日送付可]  
 成績証明書(学部)  卒業見込み証明書 [後日送付可]  
 健康診断書 [後日送付可]

※修士課程の方は学部、修士の成績証明書を併せてお送り下さい。

### 4. 結果等連絡先(必ずご記入願います)

※就職ご担当教授もしくはキャリアセンターご担当者様をご記入下さい。

※tel及びE-mailの両方を必ずご記入ください。

ご 職 位 : \_\_\_\_\_

ふりがな  
ご 担 当 : \_\_\_\_\_

tel : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

※面談日程等の詳細案内は、ご本人様へ E-mailにてご連絡させていただきます。

### 4. 連絡欄

---

---

---

## 専攻別募集職種業務内容<機械系>

職種	主な専門性	主な業務内容
研究開発	材料工学/金属材料 固体力学 塑性工学/流体工学 電子顕微鏡学	研究企画創出 新商品開発 新プロセス開発
設計技術	材料工学/機械力学 材料組成学/金属疲労学 3次元CAD作図・解析 破壊力学	コンシューマ製品設計 生産設備設計 金型設計
生産技術	制御工学/ロボット工学 シミュレーション工学 機械工作学/ VE/IE 生産システム学	生産性向上 自動機開発 生産ライン自動化・省力化 新規設備導入
製造技術	燃焼学/伝熱工学/制御工学 耐火材 構造力学/安全工学	量産技術確立/品質向上 プロセス技術開発 設備運転管理/安全衛生管理
品質保証	機械工学全般 信頼性工学	品質評価 性能向上

1

## 専攻別募集職種業務内容<電気電子系>

職種	主な専門性	主な業務内容
研究開発	電子回路工学/電子材料工学 光物性/薄膜工学 表面物性工学/半導体デバイス工学	研究企画創出 電子材料開発 新商品開発 新プロセス開発
設計技術	回路設計 通信情報工学 画像処理 機構設計	電子部品製品設計 コンシューマ製品回路設計 (デジタル/無線) 機構設計
生産技術	電気電子回路/電気電子材料 通信情報工学 画像処理/ VE/IE /ロボティクス	生産性向上 生産ライン自動化・省力化 新規設備導入
製造技術	電力工学/電気機器工学 デジタル信号処理技術 半導体デバイス技術 FEM解析技術	量産技術確立 品質向上 設備運転管理 プロセス技術開発
品質保証	電気電子全般 信頼性工学	品質評価 性能向上

2

## 専攻別募集職種業務内容<化学系>

職種	主な専門性	主な業務内容
研究開発	無機化学/有機化学 高分子化学 物理化学/表面科学 ナノ材料	研究企画創出 新材料開発 新商品開発 新プロセス開発
生産技術	化学工学/反応工学 粉流体力学/流動層工学 伝熱工学 電気化学	生産性向上 新規設備導入 成形技術開発 焼成技術開発
製造技術	無機化学/有機化学 化学工学/紛体化学 電気化学 プロセスシステム工学	量産技術確立 品質向上 設備運転管理 安全衛生管理
品質保証	化学全般/信頼性工学	品質保証/性能向上
分析	分析化学/機器分析 分光学 組織解析学	分析技術開発 分析機器仕様開発 品質評価

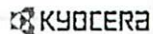
3

## 専攻別募集職種業務内容<物理系>

職種	主な専門性	主な業務内容
研究開発	結晶物性工学	研究企画創出
開発設計	電磁応用工学 固体表面科学 機能デバイス エネルギー物理学 半導体工学	新材料開発 新商品開発 新プロセス開発
製造技術	応用物理学 材料工学 薄膜工学	量産技術確立 品質向上 生産性向上
品質保証	物理学全般 信頼性工学	品質評価 性能向上
分析	ナノ物理学 分光物理学 電子・分光計測学	分析技術開発 分析機器仕様開発 品質評価

4

専攻別募集職種業務内容<情報系>



職種	主な専門性	主な業務内容
開発設計	通信情報工学 信号処理 通信プロトコル ソフトウェア開発 C言語/C++言語 エンタープライズシステム構築	コンシューマ製品開発 機器ソフトウェア開発 装置ソフトウェア開発
研究開発	信号処理技術 計測工学 ソフトウェア技術	ソリューション研究
UI	情報デザイン インタラクションデザイン 人間工学/デザイン工学	UI設計・評価
社内SE	情報処理技術	基幹系業務システム構築 ITインフラ整備

職種	主な専門性	主な業務内容
開発設計	通信情報工学 信号処理 通信プロトコル ソフトウェア開発 C言語/C++言語 エンタープライズシステム構築	コンシューマ製品開発 機器ソフトウェア開発 装置ソフトウェア開発
研究開発	信号処理技術 計測工学 ソフトウェア技術	ソリューション研究
UI	情報デザイン インタラクションデザイン 人間工学/デザイン工学	UI設計・評価
社内SE	情報処理技術	基幹系業務システム構築 ITインフラ整備

専攻別募集職種業務内容<情報系>



職種	主な専門性	主な業務内容
開発設計	通信情報工学 信号処理 通信プロトコル ソフトウェア開発 C言語/C++言語 エンタープライズシステム構築	コンシューマ製品開発 機器ソフトウェア開発 装置ソフトウェア開発
研究開発	信号処理技術 計測工学 ソフトウェア技術	ソリューション研究
UI	情報デザイン インタラクションデザイン 人間工学/デザイン工学	UI設計・評価
社内SE	情報処理技術	基幹系業務システム構築 ITインフラ整備

専攻別募集職種業務内容<情報系>



職種	主な専門性	主な業務内容
開発設計	通信情報工学 信号処理 通信プロトコル ソフトウェア開発 C言語/C++言語 エンタープライズシステム構築	コンシューマ製品開発 機器ソフトウェア開発 装置ソフトウェア開発
研究開発	信号処理技術 計測工学 ソフトウェア技術	ソリューション研究
UI	情報デザイン インタラクションデザイン 人間工学/デザイン工学	UI設計・評価
社内SE	情報処理技術	基幹系業務システム構築 ITインフラ整備

専攻別募集職種業務内容<情報系>

